**Pressemitteilung**

Nr.: REN0799(A)

**Sub-Gigahertz Wireless-Lösung von Renesas Electronics setzt sich als Kandidat für Standard Test Bed Unit für Wi-SUN-FAN-Spezifikationen durch**

*Renesas ist Teil der ersten Testphase der Wi-SUN-FAN-1.0-Zertifizierung*

Düsseldorf, 9. November 2018 – Renesas Electronics Corporation (TSE: 6723), ein führender Anbieter hochmoderner Halbleiterlösungen, gibt bekannt, dass die Wi-SUN Alliance (Anmerkung 1) sich für die Renesas Sub-GzHz-Wireless-Lösung (Sub-Gigahertz) als eine der Interoperabilitäts-TBUs (Test Bed Units; Anmerkung 2) für das Wi-SUN-FAN-Zertifizierungsprogramm (Field Area Network) entschieden hat. Renesas zählt mit seiner drahtlosen Lösung RAA604S00/RX651 zur ersten Gruppe von Unternehmen, die am Zertifizierungsprozess Wi-SUN FAN 1.0 teilnehmen. Zertifizierungen sind für Ende 2018 geplant.

Die Sub-G-Wireless-Lösung enthält die Evaluierungs-Plattform von Tessera Technology und umfasst ein Evaluierungsboard (Anmerkung 3), auf dem ein Renesas RAA604S00-Wireless- Communication-SoC (System-on-Chip), ein RX651-Mikrocontroller (MCU) sowie Kommunikationssteuerungssoftware von Renesas implementiert sind.

„Die Wi-SUN Community hat große Fortschritte bei der Entwicklung und dem Einsatz drahtloser Kommunikation in Energiemanagement-Systemen erzielt. Wir freuen uns, unser Engagement auf den Bereich Smart Energy auszuweiten und die neuesten Wi-SUN-Spezifikationen mit unserer Wi-SUN-FAN-zertifizierten Lösung und Test Bed Units voranzutreiben“, erklärt **Akihiro Kuroda, Vice President, Energy Infrastructure Business Division bei der Renesas Electronics Corporation**.

Anwender, die intelligente Zähler, intelligente Beleuchtung, Infrastrukturausrüstung oder ähnliche Produkte mit der Renesas Sub-G-Wireless-Lösung entwickeln, können entsprechend der Wi-SUN-FAN-Spezifikation die Interoperabilität zwischen Geräten problemlos sicherstellen. Dadurch können sie den Entwicklungszeitraum für Wi-SUN-FAN-konforme Anwendungsgeräte im Vergleich zu alternativen Lösungen um etwa ein Jahr verkürzen.

Das Sub-GHz-Frequenzband ist gegenüber physikalischen Hindernissen unempfindlich und kann Daten selbst in einem städtischen Umfeld über noch größere Reichweiten im Vergleich zu früheren Standards übertragen. Da sich über Mesh-Netzwerke weite Bereiche mit guter Stabilität abdecken lassen, eignet sich diese Technik ideal für Anwendungen wie intelligente Zähler, die Visualisierung des Stromverbrauchs, die Überwachung der Geräteauslastung sowie für die Verwaltung verschiedener Sensoren innerhalb eines Versorgungsunternehmens, Fabriken und Gebäuden.

**Über die Wi-SUN-Lösungen von Renesas**

Im Jahr 2015 führte Renesas mit seiner drahtlosen Lösung RAA604S00/RX63N die weltweit ersten Sub-G-Wireless-Lösungen ein, die sich nach dem Wi-SUN-HAN-Standard (Home Area Network) als zertifizierte TBU qualifizieren konnten. Neben dem Wi-SUN-HAN-Standard, der vor allem bei Systemen im Gebäudeinneren Anwendung findet, ist Renesas heute branchenführend bei Tests zur frühzeitigen Zertifizierung nach dem Wi-SUN-FAN-Standard. Dieser gilt hauptsächlich für Netzwerke für Smart Cities, intelligente Versorgungsunternehmen und andere Anwendungen, die große Netzwerke erfordern. Diese Lösung bietet Entwicklern einen schnellen Einstieg in die Erstellung von Anwendungen wie Powermanagement- und Sensorgeräte, die den Wi-SUN-FAN-Standard unterstützen. Die Beschleunigung der Geräte-Interoperabilität durch die Wi-SUN-FAN-Spezifikation unterstützt die Bereitstellung sicherer, ineinandergreifender und anpassungsfähiger Multi-Service-Netzwerke zur Verbindung wichtiger Infrastrukturen innerhalb des Energiemanagements und städtischer Umweltanwendungen, die die Grundlage für Technologien von Smart Cities bilden.

**Verfügbarkeit**

Die drahtlose Lösung RX651/RAA604S00 von Renesas für das Sub-GHz-Frequenzband wird im ersten Quartal 2019 erhältlich sein.

Anmerkung 1)

Wi-SUN Alliance Inc. ist ein internationales Industrie-Konsortium, das innerhalb des Sub-GHz-Frequenzbandes drahtlose Kommunikationsstandards definiert.

Anmerkung 2)

Test Bed Units (TBUs) sind von der Wi-SUN Alliance Inc. zertifizierte Geräteeinheiten für die Durchführung von Interoperabilitätstests.

Anmerkung 3)

Dieses Evaluierungsboard ist bei Tessera Technology Inc. erhältlich.

**Über Renesas Electronics Corporation**

Renesas Electronics Corporation liefert mit seinen umfassenden Halbleiterlösungen innovatives und zuverlässiges Embedded-Design. Als einer der [weltweit](https://www.renesas.com/en-hq/about/company/profile/global.html) führenden Anbieter von Mikrocontrollern, A&P- und SoC-Produkten sowie integrierten Plattformen steht Renesas für langjährige Expertise und höchste Qualität. Mit seiner breiten Lösungspalette fokussiert Renesas auf die Anwendungsbereiche Automotive, Industrie, Smart Home, Büroautomation sowie Informations- und Kommunikationstechnologie. Weitere Informationen unter: [renesas.com](https://www.renesas.com)

###

**Hinweis**

Wi-SUN und Wi-SUN Alliance sind eingetragene Warenzeichen der Wi-SUN Alliance Inc., und Renesas besitzt eine Lizenz zur Nutzung dieses Warenzeichens. Weitere, in dieser Pressemitteilung erwähnte Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer entsprechenden Inhaber.

**Unternehmenskontakt für Leser- und Kundenanfragen:**

Simone Kremser-Czoer

Renesas Electronics Europe GmbH, Karl-Hammerschmidt-Str. 42, 85609 Aschheim-Dornach   
Tel.: +49 89 38070-216  
E-Mail: [simone.kremser-czoer@renesas.com](mailto:simone.kremser-czoer@renesas.com)

Web: [www.renesas.com](http://www.renesas.com)

**Agenturkontakt für weitere Presseinformationen, Bildmaterial oder Artikelanfragen:**

Alexandra Janetzko

HBI Helga Bailey GmbH (PR-Agentur), Stefan-George-Ring 2, 81929 München

Tel.: +49 89 99 38 87-32

Fax: +49 89 930 24 45

E-Mail: [alexandra\_janetzko@hbi.de](mailto:alexandra_janetzko@hbi.de)

Web: [www.hbi.de](http://www.hbi.de/)